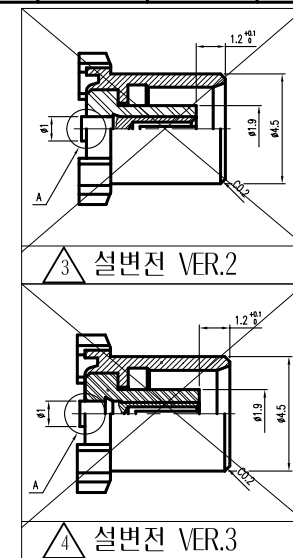
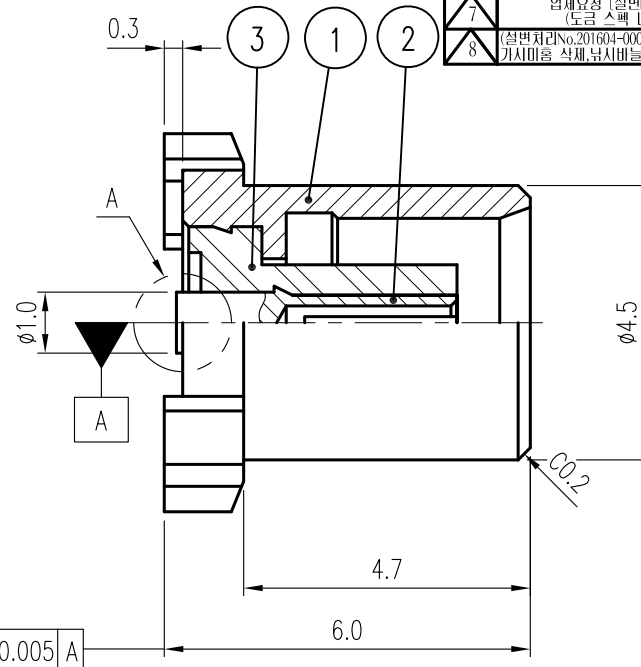
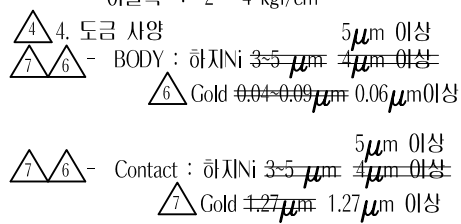


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	품질 개선으로 구조 변경	임채희	길준범	2005. 1. 7.
2	설번No.연구2005-243)원지재 변경으로 인한 설번	김인철	최종락	2005. 10. 14.
3	부처할 개선 (설번No.연구2006-121) (절연체 돌출 및 P/N 돌출 현상으로 변경)	김인철	윤상진	2006. 5. 30.
4	부처할 개선 (설번No.연구2006-242) (평탄도 불량 및 도금 스펙 변경)	김은희	윤상진	2006. 12. 21.
5	[설번No.연구2007-033]시험성 형상		윤상진	2007. 2. 6.
6	임채요청 (설번No.연구2007-101) (도금 스펙 내용 변경)	김은희	윤상진	2007. 6. 13.
7	임채요청 (설번No.연구2007-138) (도금 스펙 내용 변경)		윤상진	2007. 8. 16.
8	(설번저리No.201604-0007)조립성 개선으로 인한 가시미홀 삭제.납시배를 추가 및 대포로변경	김천경	김인철	2016. 4. 22.



주 기

1. 가시미 부분 조립후 확인 바람



8543 76543 876543		3	INSULATOR	1	TEFLON	DIN02757-N1 DIN01381-N1	
		2	CONTACT	1	BeCu	주기 참조	DCT01264-5/1 E1183
		1	BODY	1	MBsBD	주기 참조	DBD00079-5/1
대체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공동허용치 소수 각도 분수 ± 0.03 ± 0.1° —		년월일 2016. 04. 22.			KJCOMTECH RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 도명 MCX50-J-4R-R VER.7		
		승인	김인철				
		검도	이현진				
재질		검도	도명				
열처리		검도					
보호파막처리		제도	김찬경		A4 도번 CN00728-7/1 K313-431-001		
		작성부서 연 구 소					
		적도 6/1	단위 mm	총량			